

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML6

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	400		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		4
		105	L2	
B-RS-FR4-ML-0.71mm-105+105-TG150-HF	50200961	710		5
		105	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	40		6
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	300		7
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	40		10
		105	L4	
B-RS-FR4-ML-0.71mm-105+105-TG150-HF	50200961	710		11
		105	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	400		12
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		13
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		14
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	15

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3090 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik